

新思科技:有信心2025上半年完成收购Ansys

本报讯 记者姬晓婷报道:新思科技(Synopsys)以350亿美元收购Ansys的交易有了新进展,从目前公布的情况来看,该收购很可能在第一阶段就获得英国批准。12月20日,英国竞争与市场管理局(CMA)发布公告称,该收购提议可能会削弱英国某些半导体芯片设计和光仿真产品的竞争力。但同时表示,如果这个问题得到解决,该交易可能会获得批准。对此,新思科技作出回应,已经采取措施来解决CMA提出的关切,并表示仍然有信心交易将在2025年上半年完成。

今年1月,美国EDA软件公司新思科技和美国仿真软件公司Ansys共同宣布,双方已经就新思科技收购Ansys事宜达成了最终协议,新思科技将以现金和债务融资相结合的方式,以总价值约350亿美元收购Ansys,并表示该交易预计将于2025年上半年完成。随后,该交易会进入监管机构审核流程。

此次发布的内容便是CMA作为英国市场监管机构对该并购案第一阶段调查结果的披露。CMA的第一阶段调查发现,尽管两家公司提供的产品在很大程度上是互补的,但该交易可能会削弱三种软件产品供应领域的竞争,即数字芯片RTL功耗分析软件、光学软件和光子软件。



市场人士认为,新思科技将其光学解决方案集团出售给是德科技,可以有效解决CMA关切,并使交易可以在CMA审查第一阶段就获得批准,无需进入第二阶段。

新思科技发布声明称,本次CMA发布的公告是英国履行监管流程中预料之内的一个步骤,新思科技已经采取了相关措施来解决CMA在第一阶段调查后提出的所

有关切。比方说,新思科技如果完成收购Ansys的交易,将把光学解决方案集团出售给是德科技。同时,新思科技表示,对当前的监管审查流程能够取得积极结果充满信心,并仍然预计交易将在2025年上半年完成。

新思科技是当前全球最大的芯片设计工具软件和IP企业之一,Ansys已成为全球领先的电磁、结

构、流体、芯片设计软件开发商,其产品及解决方案广泛应用于航空航天、交通、通信、能源等诸多行业。当前,包括新思科技在内的EDA头部企业都在积极拓展产品线,争取将下游市场从半导体拓展到更广泛的系统级客户。收购Ansys是新思科技拓展市场过程中非常关键的一个环节,将直接影响到新思科技未来在细分领域的影响力。

2025年HBM出货量同比增长70%

本报讯 记者许子皓报道:12月25日,TechInsights发布了2025年存储器市场展望。TechInsights表示,得益于人工智能技术(AI)及相关技术的加速采用,包括DRAM和NAND的存储器市场,预计2025年会实现显著增长。

TechInsights认为,在探索存储器市场的复杂性时,出现了几个关键趋势:一是AI持续推动对高带宽内存(HBM)的关注。随着AI的兴起,特别是在机器学习和深度学习等数据密集型应用中,对HBM的需求空前高涨。预计HBM出货量将同比增长70%,因为数据中心和AI处理器越来越依赖这种类型的存储器来处理低延迟的大量数据。HBM需求的激增预计将重塑DRAM市场,制造

商将优先生产HBM,而不是传统的DRAM产品。

二是AI推动了对大容量固态硬盘(SSD)和QLC NAND技术的需求。随着AI继续渗透各行各业,对SSD的需求也在上升。这对于需要大量数据存储和快速检索时间的AI工作负载尤其关键。因此,预计QLC NAND技术的采用率将增加,该技术可以用较低的成本提供更高的密度。尽管QLC SSD的写入速度比其他NAND类型慢,但由于其成本效益和适合AI驱动的数据存储需求,它们将获得更多青睐。预计数据中心NAND bit需求增长继续,2024年约70%的爆炸性增长之后,将在2025年超过30%。

三是资本支出投资大幅转向

DRAM和HBM。受AI应用激增的推动,内存市场的资本支出越来越多地流向DRAM,特别是HBM。随着制造商扩大产能以满足日益增长的需求,DRAM资本支出预计将同比增长近20%。然而,这一转变导致对NAND生产的投资极少,可能在市场上造成潜在的供应瓶颈。NAND领域的盈利能力持续改善,这可能会在2026年重新点燃该领域的投资热情。

四是边缘AI开始崭露头角,但要到2026年才会产生显著影响。边缘AI将AI处理功能更接近智能手机和PC等设备的数据源,预计将在2025年进入市场。然而,该技术的全面影响要到2026年才会显现。具有真正设备端AI功能

的设备预计将在2025年年底推出,但销量可能不足以立即影响存储器市场。真正的转变应该发生在2026年,随着边缘AI变得更加普及,将推动对适合这些新功能的内存解决方案的需求。

五是数据中心AI重点延迟了传统服务器更换周期。对AI驱动的数据中心的关注导致传统服务器基础设施的更换周期延迟。许多企业正在将资源转移到升级其AI能力上,导致传统服务器需要更新。虽然这种延迟在短期内可能是可控的,但在某个时候,这些服务器将需要更新,这可能会推动DRAM和NAND需求的突然激增。这种延迟的更换周期一旦发生,可能会推动存储器需求显著增加。

英飞凌举办碳化硅媒体发布会 助力行业绿色可持续发展

本报讯 记者许子皓报道:近日,德国芯片大厂英飞凌举办了年度碳化硅媒体发布会。会上英飞凌科技高级副总裁、工业与基础设施业务大中华区负责人于代辉表示:“Yole Intelligence调查报告显示,碳化硅市场预计将从2024年的31亿欧元增长至2029年的90亿欧元,年复合增长率超24%。同时,碳化硅是实现可持续能源生产和消费的核心技术,英飞凌将持续聚焦碳化硅技术在绿色能源领域的应用,加强研发和创新,推动能源领域的绿色化转型。”

媒体会上,英飞凌还重点介绍了前段时间发布的两款碳化硅产品——CoolSiC MOSFET G2以及XHP2 CoolSiC MOSFET半桥模

块。据了解,英飞凌发布的CoolSiC MOSFET G2具备业界领先的功率密度,最高可达7毫欧,使得其在相同体积下,能够实现更高的功率输出,提高能源转换效率。英飞凌表示,该产品在硬开关、软开关、轻载等工况下均表现优异,既能减少能量浪费,又能提高系统整体效率。在散热性能方面,第二代CoolSiC MOSFET采用了如XT互连技术和扩散硅技术等先进的封装技术,降低了热阻,热阻值从0.68K/W降低到0.5K/W,热表征值从0.28K/W降低到0.18K/W,使热量能更高效地从芯片结点散出,有助于降低结点温度,还能提升器件的输出功率。即使是在恶劣的工况下,该产品仍能保证器件在高功率

运行时的稳定性和可靠性。

XHP2 CoolSiC MOSFET半桥模块则是具备了高集成度与高功率处理能力,其额定电压为3.3千伏,集成了XT技术,其高集成度的设计使得模块在处理高电压、大功率应用时,具有出色的性能表现,能够满足电力机车、工业传动等领域对高功率的需求。此外,借助碳化硅材料的优异特性以及先进的模块设计,实现了高效的能源转换。在欧洲电力机车的应用案例显示,该模块能够帮助实现用电量的大幅节能,每年可节省约30万度电,相当于100个欧洲家庭的年用电量,不仅显著降低了能源消耗,还大幅提高了能源利用效率,为绿色能源转型做出了实质性贡献。

英飞凌表示,这两款产品能够覆盖光伏、储能、充电桩、电力机车等车用和工业场景,而且可以根据不同场景的具体需求,发挥出更具针对性的性能特点,促进这些行业向高效率、更可持续的方向发展。

于代辉表示:“绿色、环保、低碳已成为广泛共识,碳化硅作为实现可持续能源生产和消费的核心技术,市场潜力巨大。根据IEA报告,从发电到用电的整个能源链条,各环节市场均呈现强劲增长态势。面对这一高速增长的市场,英飞凌凭借自1992年以来在碳化硅领域的持续研发和创新,致力于解决碳化硅产品在一致性、领先性、创新性、经济性及适应性等方面的痛点,以满足客户需求。”

联发科发布天玑8400移动芯片 首发机红米Turbo4将于元旦后发布

本报讯 记者姬晓婷报道:12月23日,联发科(MediaTek)举行天玑8400 5G全大核智能体AI芯片新品发布会。活动上,小米中国区市场部副总经理、REDMI品牌总经理王腾表示,红米Turbo4将首发搭载天玑8400+Ultra芯片,这也是红米2025年首款新机,预计

于2025年元旦后发布。

天玑8400包含8个最高主频达3.25GHz的Arm Cortex-A725大核,CPU多核性能相较上一代芯片提升41%,多核功耗相较上一代降低44%,助力终端电池续航时间更持久;搭载Arm Mali-G720 GPU,GPU峰值性能相

较上一代芯片提升24%,功耗降低42%;集成联发科旗舰级AI处理器NPU 880,提供高速生成式AI任务处理能力,支持全球主流的大语言模型(LLM)、小语言模型(SLM)和多模态大模型(LMMs),可为用户提供AI翻译、改写、上下文智能回复、通

话摘要、多媒体内容生成等终端侧生成式AI体验。

天玑8400还搭载了在天玑9400旗舰芯片中率先亮相的MediaTek天玑AI智能体化引擎(Dimensity Agentic AI Engine),该引擎可以将传统的AI应用程序重构为更先进的智能化AI应用。

对标美国Figure 02 矩阵超智推出人形机器人MATRIX-1

本报讯 记者王伟报道:12月26日,上海矩阵超智集成系统有限公司(以下简称“矩阵超智”)正式推出全尺寸通用型人形机器人MATRIX-1,并宣布将于2025年实现小规模量产。

据介绍,MATRIX-1由矩阵超智团队历时132天打造,对标美国人形机器人公司Figure AI推出的人形机器人Figure 02。MATRIX-1身高1.8米,纤细外形设计,外壳采用柔和的石墨白颜色,体重约为65公斤;MATRIX-1全身拥有77个自由度,髋关节3个自由度,颈部4个自由度;腰部紧贴后侧,最大关节扭矩382N·m,能够完成多种复杂动作,具备高度协调的运动能力,动作流畅自然。在运动能力方面,MATRIX-1行走速度为每小时8公里,双臂最大负重能力35公斤;在续航方面,MATRIX-1采用高能量密度电池,一次充电可运行5小时。同时,MATRIX-1头部配备一块显示屏,可用于人机交互。

据介绍,MATRIX-1注重人机交互安全性,采用自主开发全球首创的新型柔性复合材料龙鳞状覆盖结构设计,是全球首个采用新型复合材料全身包裹的人形机器人,其人形机器人本体肩膀、腰胯、手肘窝等可活动关节,采用国际创新的柔性复合材料,软硬材质一体化,展现出更高的柔韧性、抗冲击性、高强度比、热稳定性、灵活性和美观一致性;表面集成了触觉传感,有类人皮肤触感与温度感知能力。

值得注意的是,MATRIX-1配备自研的第三代五指触觉灵巧手,拥有22个自由度和触觉感知。每只灵巧手搭载自研全球独创微型行星滚柱丝杠直驱技术,便于大批量生产,成本低;同时手指关节具有高力矩精度和透明度,运动更加精细

和平滑,能够完成复杂的抓握任务。其首测实现了97%以上成功率的通用物体抓取,支持六自由度操作,即使是透明反光物体也能通过三维视觉算法进行抓取。

除了具备强大的硬件基础,人形机器人在系统软件方面亦可圈可点。MATRIX-1计算系统搭载自研的高性能感知及运动控制软件和算法,接入自研用于语音交互和视觉推理的MLM3.0三层级多模态大模型,端到端AI驱动,拥有强大的学习、自适应和决策能力,能够与人类进行实时的语音对话,自主执行各种复杂任务。

同时,MATRIX-1接入自研全球首个集群泛化通用具身智能模型“大脑”,可以同时部署上百台机器人,能够在新的未知地形环境里面进行协同作业。这个“大脑”人工智能系统,由云—边—端组成,支持基于模型的行为编排与任务执行,具备全模态感知、少样本学习、任务闭环处理及强化人机交互的能力和运动控制能力。

此外,矩阵超智还公开其2025年发展计划:上半年推动MATRIX进入汽车和家电工厂等非结构化生产制造环节,在装配、物料搬运/转运、检测、维护等工序场景“实训”,并计划在2025年下半年实现数百台MATRIX产品的量产。

据悉,矩阵超智于2024年4月成立,公司专注通用人工智能(AGI)人形机器人全栈式技术研制及商业化创新应用,致力为全球客户提供AGI人形机器人创新产品和解决方案。其创始人及团队来自特斯拉、英伟达、OpenAI等科技巨头,曾经主导和参与业界知名人形机器人、自动驾驶、芯片算力、数据合成和人工智能大模型的研发工作。



谷歌推出首个通用推理模型

本报讯 谷歌AI Studio平台近日发布实验性的“Gemini 2.0 Flash Thinking”模型,主打“清晰展现思考过程”,这也是谷歌发布的第一个通用推理模型。

该模型不仅能够解答复杂问题,还能模仿人类逐步推理,展现其“思考”步骤,这一创新功能有望革新AI领域,和OpenAI的o1推理模型展开竞争。

Google DeepMind首席科学家Jeff Dean演示了该模型如何通过一系列“思考”步骤解决物理问

题;而Google产品负责人Logan Kilpatrick展示了模型如何处理包含图像和文本信息的推理问题。

该模型基于Gemini 2.0 Flash的速度和性能构建,在Chatbot Arena LLM排行榜上,Gemini 2.0 Flash Thinking模型在所有类别中均排名第一,较之前的Gemini-2.0-Flash模型有显著提升,尤其在“硬提示”和“视觉”两项分别提升了14分和16分。该模型目前已在Google AI Studio和VertexAI平台上线。(谷文)

科大讯飞发布讯飞AI录音笔S8离线版

本报讯 近日,科大讯飞发布旗舰新品——讯飞AI录音笔S8离线版,其可以完全隔绝外部网络实现转文字、翻译功能,为政企群体提供专业可靠的信息记录与整理解决方案。

科大讯飞录音笔产品负责人吴和盛表示,在政企事务中,智能办公产品只有守好信息安全的底线,才能称得上是“可靠”的助手。

讯飞AI录音笔S8离线版具有录音及转写文本内容的高保密性。在硬件上,讯飞AI录音笔S8离线版机身没有Wi-Fi、蓝牙、SIM卡等任何无线通信模块,信息不会上传云

端。“锁屏密码+文件密码+芯片一机一密”三重保障,为机密信息的存储安全再次加码,使用国密二级认证的独立芯片,通过国密算法为文件加密,单独存储在加密文件夹中进行物理隔离,查看、编辑、导出等操作均需要验证密码,即便通过暴力手段将存储模块拆解也无法强行破解文件。另外,在导出文件时,这款录音笔可以直连UOS系统、银河麒麟等九大主流信创系统。这些守护信息安全的功能尤其适用于政府部门的会议、调查取证等录音场合。(齐旭)